MINISMDC260F-2 产品详细信息

MINISMDC260F-2

TE 内部编号： RF1411-000

PolySwitch 可复位器件

产品亮点:

应用 = 表面贴装式
Vmax 工作 = 6 V
Vmax = 6 V
Imax = 100 A
名称 = miniSMD

查看所有特性

要查找类似产品，请选择您希望更改的特性。

Vmax 工作 (V)

6

Vmax (V)

6

Imax (A)

100

IH（室温） (A)

2.6

IT （室温） (A)

5.00

Rmin (Ω)

0.015

R1 最大（脱扣后） (Ω)

0.043

结构 表面贴装式

波形因数（英寸）

1812

波形因数（mm）

4532

符合 RoHS/ELV 标准

符合 RoHS 标准
符合 ELV 标准

无铅焊接制程

回流焊最高可达 245°C
回流焊最高可达 260°C

工作温度（最高） (°C)

85

应用

表面贴装式

> 名称 miniSMD

产品特性（请使用产品图纸进行所有设计工作。）	
产品类型特性: UL 认证 = 文件编号 E74889 CSA 文件号 = CA78165 **电气特点:** Vmax 工作 (V) = 6 Vmax (V) = 6 Imax (A) = 100 IH（室温） (A) = 2.6 IT （室温） (A) = 5.00 Rmin (Ω) = 0.015 R1 最大（脱扣后） (Ω) = 0.043 Power Dissipation (Max) (W) = 1 **端接特性:** 结构 = 表面贴装式 **触点特性:** 名称 = miniSMD	**配置特性:** 波形因数（英寸） = 1812 波形因数（mm） = 4532 **行业标准:** 符合 RoHS/ELV 标准 = 符合 RoHS 标准，符合 ELV 标准 无铅焊接制程 = 回流焊最高可达 245°C，回流焊最高可达 260°C RoHS/ELV 符合记录 = 一直符合 RoHS TUV 证书编号 = R72041438 **环境:** 工作温度（最高） (°C) = 85 **操作/应用:** 应用 = 表面贴装式 **包装特性:** 包装方式 = 卷盘包装